

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 28959.

Kl. 21 g, 10/01.
H01g 13/00

Państwowe Zakłady Tele- i Radjotechniczne w Warszawie*), Warszawa.

Sposób wyrobu kondensatorów zmiennych.

Zgłoszono 13 listopada 1935 r.

Udzielono 7 sierpnia 1939 r.

Przy wyrobie kondensatorów zmiennych zwraca się dużą uwagę na ustawienie i zamocowanie we właściwym położeniu względem siebie płytek obu części kondensatora, ruchomej i nieruchomej, ponieważ od dokładności montażu zależy dobroć kondensatora.

Stosowany dotychczas sposób wyrobu kondensatorów polega na wykonywaniu oddzielnie zespołu płytek części nieruchomej, oddzielnie zaś zespołu części ruchomej kondensatora, a następnie umocowaniu w obudowie kondensatora obu tych części, każdej z osobna.

Sposób ten naraża na pewne trudności przy wykonywaniu dokładnych kondensatorów, ponieważ tolerancja całkowita kon-

densatora zależy od sumy tolerancji jego części składowych.

Sposób wyrobu kondensatorów zmiennych, który stanowi przedmiot niniejszego wynalazku, polega na tym, że zespoły płytek obu części kondensatora, ruchomej i nieruchomej, są zamocowywane odpowiednio w jednym wspólnym przyrządzie, w którym płytki te są utrzymywane we właściwym położeniu względem siebie, następnie płytki każdego z zespołów kondensatora są przymocowywane do siebie bez usuwania przyrządu względnie tej części lub tych części przyrządu, które utrzymują płytki we właściwym położeniu, po czym dopiero przyrząd ten względnie jego część lub części są usuwane.

*) Właściciel patentu oświadczył, że wynalazcą jest inż. Jerzy Glass.

Taki sposób wykonywania kondensatorów ułatwia ustawianie we właściwym położeniu względem siebie płytek kondensatora bez przekroczenia dopuszczalnych tolerancyj.

Sposób według wynalazku można rozwinąć dalej, a mianowicie przyrząd, w którym płytki były układane, względnie część lub części przyrządu, utrzymujące wzajemne położenie płytek kondensatora, można usuwać dopiero po umocowaniu płytek do osi i do obudowy kondensatora.

Przy takim sposobie wyrobu kondensatorów unika się całkowicie błędów i niedokładności w ustawieniu części kondensatora, jakie mogłyby powstać przy zwykłym stosowanym sposobie umocowywania części kondensatora do obudowy.

Sposób według wynalazku może być również zastosowany do wyrobu kondensatorów wielokrotnych, np. podwójnych lub potrójnych, posiadających wspólną oś i wspólną obudowę. W tym przypadku należy szczególnie dokładnie ustawić płytki części ruchomych i nieruchomych kondensatorów składowych we właściwym położeniu względem siebie. Przy zastosowaniu sposobu według wynalazku przyrząd lub przyrządy, w których były układane płytki kondensatorów składowych, względnie część lub części przyrządów, utrzymujące wzajemne położenie płytek kondensatorów składowych, są usuwane dopiero po umocowaniu płytek kondensatorów składowych do osi i do obudowy, wspólnych dla wszystkich kondensatorów składowych.

Przy zastosowaniu sposobu według wynalazku zespoły płytek części ruchomych i nieruchomych każdego z kondensatorów składowych są umieszczane we wspólnym przyrządzie, w którym płytki te są utrzymywane we właściwych położeniach względem siebie, po czym płytki każdego z zespołów są przymocowywane do siebie, następnie zespoły płytek ruchomych i nieruchomych kondensatorów skła-

dowych są umieszczane w obudowie i przymocowywane do osi i obudowy, wspólnych dla wszystkich kondensatorów składowych, po czym dopiero usuwa się przyrząd lub przyrządy, względnie ich części, które utrzymywały płytki kondensatorów we właściwym położeniu względem siebie.

Sposób według wynalazku daje szczególnie dobre wyniki przy masowej produkcji kondensatorów danego typu, zwłaszcza zaś kondensatorów wielokrotnych, ponieważ sposób według wynalazku pozwala utrzymać znaczną jednolitość produkcji, co nastręcza duże trudności przy zastosowaniu znanych sposobów wyrobu kondensatorów.

Przymocowywanie płytek do siebie oraz przymocowywanie ich do osi i obudowy może być przeprowadzone dowolnym odpowiednim sposobem; można tu na przykład zastosować spawanie lub lutowanie. Szczególnie dobre wyniki daje lutowanie. Najlepiej przy tym zastosować następujący system lutowania: pomiędzy części lutowane założyć folię z materiału wiążącego, części lutowane docisnąć do siebie, po czym ogrzewać miejsce lutowane do temperatury, potrzebnej do zlutowania.

Sposób według wynalazku może być zastosowany do wyrobu kondensatorów zmiennych dowolnego rodzaju; przyrząd, w którym są umieszczane płytki kondensatora, może posiadać dowolną budowę, odpowiednią do danego celu. Przyrząd ten może na przykład zawierać odpowiednią liczbę płytek dystansowych.

Płytki obu zespołów kondensatora układa się w przyrządzie w takiej kolejności, w jakiej mają się one znajdować w gotowym kondensatorze, przy czym pomiędzy płytkami kondensatora układa się płytki dystansowe. Płytki dystansowe oraz inne części przyrządu są tak wykonane, że utrzymują płytki kondensatora we właściwych odstępach i we właściwych położe-

niach. Dalszy przebieg wykonania kondensatora omówiono wyżej.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób wyrobu kondensatorów zmiennych, znamienny tym, że zespoły płytek obu części kondensatora, ruchomej i nieruchomej, są umieszczane w jednym wspólnym przyrządzie, w którym płytki są utrzymywane we właściwym położeniu względem siebie, po czym płytki każdego z zespołów kondensatora są przymocowywane do siebie bez usuwania przyrządu, względnie tej części lub tych części przyrządu, które utrzymują płytki we właściwym położeniu.

2. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że przyrząd, względnie część lub części przyrządu, utrzymujące płytki kondensatora we właściwym położeniu względem siebie, zostają usunięte dopiero po przymocowaniu płytek do osi i do obudowy kondensatora.

3. Sposób według zastrz. 1, w zastosowaniu do wyrobu kondensatorów wielokrotnych, np. podwójnych lub potrójnych, znamienny tym, że przyrząd lub przyrządy, względnie części przyrządów, utrzymujące płytki kondensatorów we właściwym położeniu względem siebie, zostają usunięte dopiero po przymocowaniu płytek do osi i do obudowy, wspólnych dla wszystkich kondensatorów składowych.

4. Sposób według zastrz. 1 — 3 znamienny tym, że przymocowywanie płytek do siebie oraz do osi i do obudowy jest dokonywane przez lutowanie.

5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że pomiędzy częściami lutowanymi jest umieszczana folia z materiału wiążącego, po czym miejsce lutowania jest ogrzewane do temperatury potrzebnej do zlutowania.

Państwowe Zakłady
Tele- i Radjotechniczne
w Warszawie.